



写真は特注機

特長

- ・高精度で安定した測定、レーザー挟み込み方式にも対応
- ・非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- ・透明体、あるいは鏡面体の測定が可能
- ・Z軸スライダ - 搭載により、測定範囲の狭い高精度センサー - でも、ストレス無く基準距離調整が可能
- ・測定対象物による影響が非常に少ない
- ・多彩な計測モードを用意
- ・ご使用の対象物形状に合わせてシステム構築が可能

低価格

ウェハの厚み測定など
小型で場所をとりません
高速測定
標準機（XY軸型）と特注機
（回転型）があります

用途

- ・レンズやガラス基板の厚み測定
- ・液晶基板や半導体ウェハの厚み測定
- ・ステンレスやチタン、アルミ、鉄板などの金属製品
あるいは樹脂、ゴム、フィルム、ガラスなどの非金属製品の厚み測定

・仕様

以下は標準機の仕様です

レーザーセンサ部

項目	仕様
測定基準距離	20mm
Z軸方向測定範囲	±3mm
測定方式	三角測距式
透明体・鏡面体・粗面の計測	可
繰り返し精度	0.02 μm (注1)

(注1) レーザセンサの単体精度です。またレーザセンサは変更することが可能です。(但しステージ部に搭載可能であること)

XY自動ステージ部

型式	TS21-100XY	TS21-200XY
移動量 (XY方向測定範囲)	110 × 110mm	210 × 210mm
テーブル面	120 × 120mm	220 × 220mm
センサ部Y軸スライダ(手動)	±25mm	
センサ部Z軸スライダ(手動)	±10mm	
最小送り量	0.5 μm/STEP(設定可変)	
最高移動速度	40mm/SEC(機械的最大)	
耐荷重	20Kg	
位置決め精度	15 μm以内 (最大移動時)	20 μm以内 (最大移動時)
繰り返し位置決め精度	±1 μm以内	
真直度	10 μm以内 (最大移動時)	15 μm以内 (最大移動時)
バックラッシュ・ロストモーション	±1 μm以内/5 μm以内	
外形寸法	W300 × H350 × D300以下	W550 × H350 × D550以下
重量	40Kg以下	55Kg以下

制御部

項目	仕様
軸数	2軸
ステージドライバ	5相マイクロステップドライバ
USB/F	USB1.1/2.0
外形・重量	W280 × H140 × D250 5Kg以下
消費電力(動作時最大)	AC100V ± 10% 50/60Hz 60W以下 AC100V ± 10% 50/60Hz 120W以下
PC三次元専用ソフトウェア WinLaser3D	OS Windows2000,XP,Windows7対応

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

メカ方式の違うものも取り揃えております。また、この仕様以外にも対応可能ですのでご相談ください

以下は写真の特注機の仕様です

項目	仕様	
測定基準距離	150mm	
Z軸方向測定範囲	±40mm	
測定方式	三角測距式	
光源	レーザー	半導体レーザー
	波長	650nm 可視光CLAS3R
	出力	4.8mW
スポット径	120 × 1700 μm	
直線性	±0.05% F.S	
測定精度	±5 μm	
センサ部移動量	Z軸ステージ(手動)	±30mm
Y自動ステージ部	移動量	=340°以上 Y=200mm以上
	最小送り量	=0.036°/STEP Y=1 μm/STEP
	最高移動速度	=36°/STEP Y=40mm/SEC
	耐荷重	5Kg
	位置決め精度	40 μm以内
	繰り返し位置決め精度	±5 μm以内
	バックラッシュ・ロストモーション	=5 μm以内、Y=80 μm以内
制御部	外形・重量	W370 × H630 × D560 40Kg以下
	パソコン	PC/AT互換機
	ステージドライバ	5相マイクロステップドライバ
	アナログ部	電圧入力(±3V,±5V,±8V,±10V,other) 16Bit A/D変換
	USB/F	USB1.1/2.0
PCソフトウェア	外形・重量	約 W433 × H140 × D255 7Kg以下
	厚み測定専用プログラム	OS Windows2000,XP,7対応

* レーザセンサの変更などユーザー様の仕様で製作いたします。

非接触測定機の専門メーカー



株式会社テクノミュー

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2-54-17

計測システム部 TEL: 04-2945-1483 FAX: 04-2945-9541

E-mail: tm_info@technomu.co.jp URL: <http://www.technomu.co.jp>